

## 株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
配当金支払株主確定日	期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所プライム市場
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

## サムコナウのご紹介

「研究者の皆様と産業界の橋渡し」をコンセプトにした広報誌サムコナウ (samco NOW) の120号発刊にあたり、表紙デザインとレイアウトを一新しました。当社をよりご理解いただくためにもぜひアクセスしてください。



<https://www.samco.co.jp/company/samconow/>



サムコ株式会社

証券コード 6387

第44期 中間報告書  
2022.08.01 ▶ 2023.01.31





2023年4月

左：代表取締役社長兼COO 川邊 史  
右：代表取締役会長兼CEO 辻 理

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

当社第44期中間期の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

## 第44期中間期の事業環境と経営成績

半導体等電子部品業界におきましては、当社の関わる化合物半導体及び電子部品製造装置の販売マーケットにおいて5G（第5世代移動通信システム）スマートフォン向けや自動車向けセンサーなどの電子部品分野、あるいはMEMS（Micro Electro Mechanical Systems＝微小電気機械素子）といった先端分野での投資が幅広い企業で進み、半導体等電子部品製造装置の需要は拡大しております。

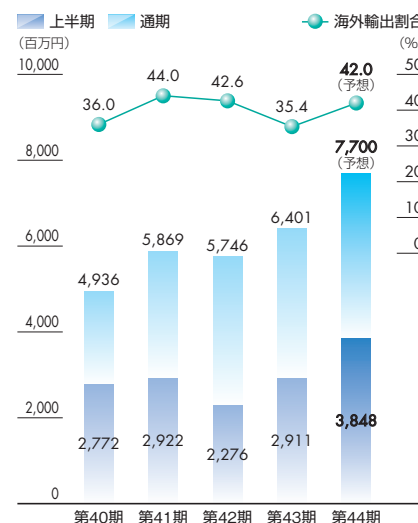
このような状況の下、当社ではオプトエレクトロニクス分野では半導体レーザー用途、電子部品・MEMS分野では高周波デバイス、パワーデバイス用途、シリコン分野では欠陥解析用途、実装・表面処理分野では各種表面改質用途、表示デバイス分野ではVRディスプレイ用途、その他分野では多目的の研究開発、医療・バイオテクノロジー用途向けの製造装置の販売実績がありました。また、新規事業（ヘルスケア事業）の創出に向けた技術開発への取り組みや、水蒸気を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma（アクアプラズマ）洗浄装置の拡販による新たな事業領域の拡大に注力いたしました。

以上の結果、当第2四半期累計期間における業績は、売上高が3,848百万円（前年同期比32.2%増）、営業利益は964百万円（前年同期比84.3%増）、経常利益は982百万円（前年同期比78.9%増）、四半期純利益は700百万円（前年同期比83.5%増）となりました。

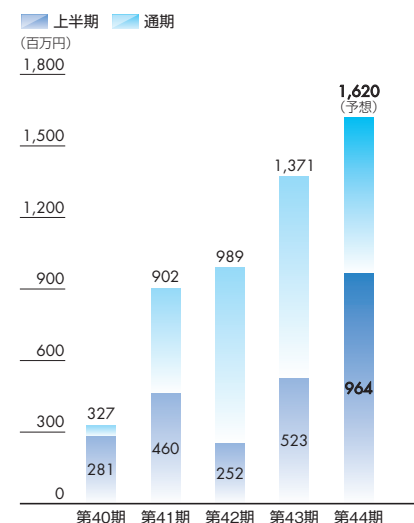
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。

なお、配当につきましては、通期での実施を予定しておりますので、株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

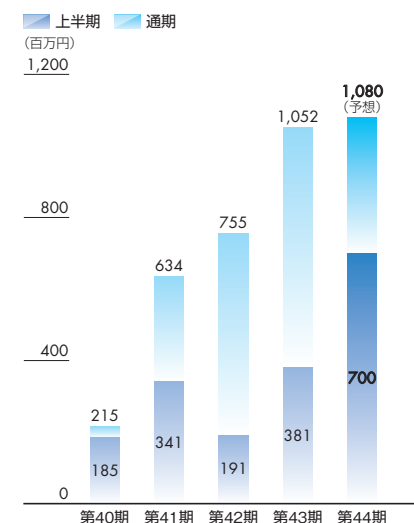
## ■ 売上高・海外輸出割合



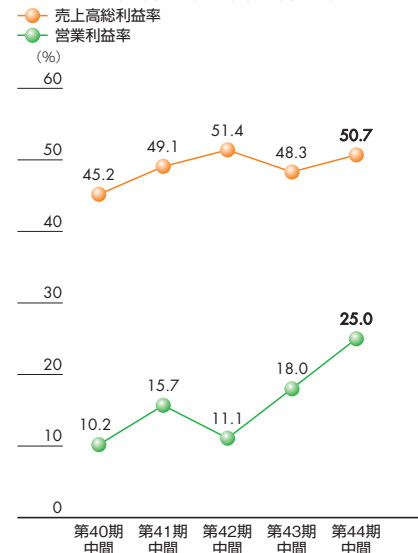
## ■ 営業利益



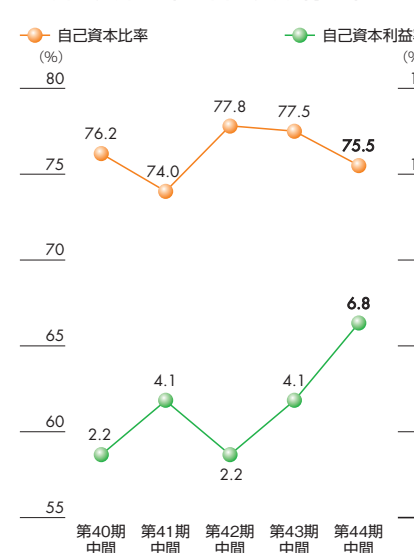
## ■ 中間(当期)純利益



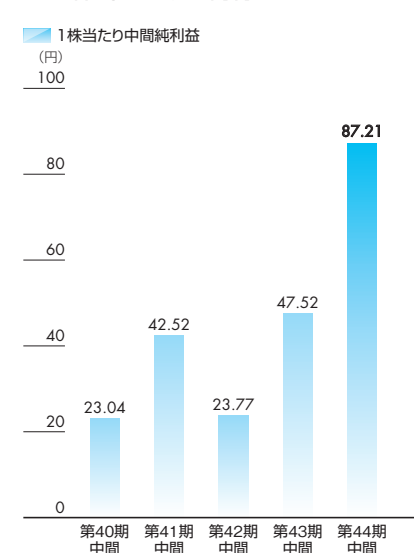
## ■ 売上高総利益率・営業利益率



## ■ 自己資本比率・自己資本利益率



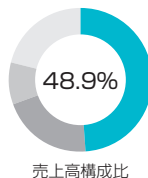
## ■ 1株当たり中間純利益



## 品目別販売状況

### エッチング装置

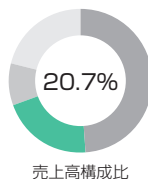
売上高 **1,881**百万円  
(前年同期比 **39.2%**増) ↑



▶ オプトエレクトロニクス分野の半導体レーザー用途や電子部品分野の高周波デバイス、シリコン分野の欠陥解析用途での販売があり、売上高は1,881百万円（前年同期比39.2%増）となりました。

### CVD装置

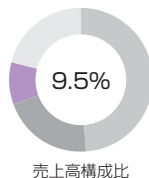
売上高 **797**百万円  
(前年同期比 **47.0%**増) ↑



▶ オプトエレクトロニクス分野の半導体レーザー用途や電子部品分野の高周波デバイス用途での販売があり、売上高は797百万円（前年同期比47.0%増）となりました。

### 洗浄装置

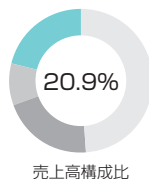
売上高 **366**百万円  
(前年同期比 **137.3%**増) ↑



▶ オプトエレクトロニクス分野の半導体レーザー用途や実装・表面処理分野の各種表面改質用途での販売があり、売上高は366百万円（前年同期比137.3%増）となりました。

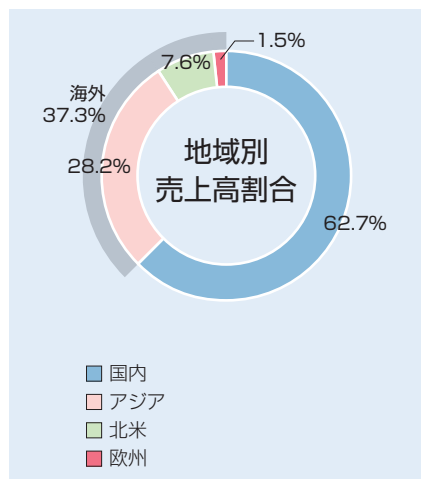
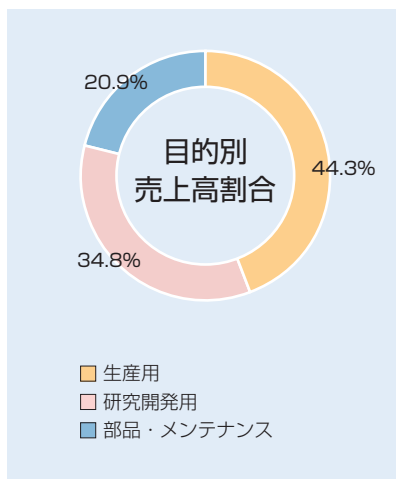
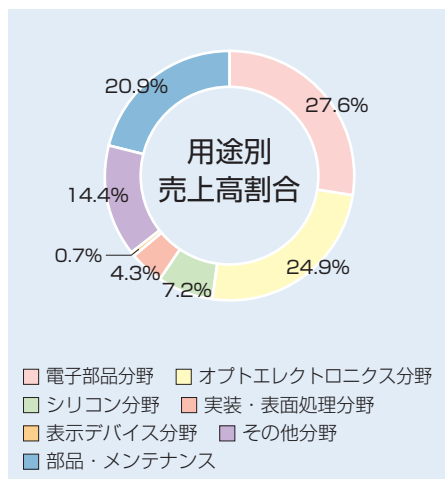
### 部品・メンテナンス

売上高 **803**百万円  
(前年同期比 **6.9%**減) ↓



▶ 既存装置のメンテナンスや部品販売、装置の移設・改造などで、売上高は803百万円（前年同期比6.9%減）となりました。

## 売上高割合状況



当社は、皆様の快適な暮らしを支える半導体や電子部品を製造する装置を製造・販売しております。薄膜を微細加工するエッチング装置、薄膜を形成するCVD装置・ALD装置、基板表面をクリーニングする洗浄装置などの独自の製品を世界中に提供しています。

次世代通信や自動運転、電気自動車などの技術革新に伴い、当社の薄膜技術を利用した製造装置の需要は今後高まっていくと予想されます。「**薄膜技術で世界の産業科学に貢献する**」という経営理念の下、これからも事業を通じて省エネ・脱炭素社会の実現に貢献していきます。

サムコの装置	製造されるデバイス	最終製品の例
 エッチング装置	 LED (発光ダイオード)	 スマートフォン・ウェアラブル端末  VRヘッドセット
 CVD装置・ALD装置	 LD (半導体レーザー)	 3D顔認証システム  データセンター
 洗浄装置	 F-BAR (高周波フィルタ)	 自動運転・電気自動車  5G・次世代通信、光通信
	 パワーデバイス	 発電システム  ヘルスケア

新製品

新型プラズマALD装置「AD-800LP」の販売を開始

2022年10月、最先端量子デバイスの研究開発や、脱炭素を実現する炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）を材料とした次世代パワー半導体デバイスのゲート酸化膜形成用の新型プラズマALD装置「AD-800LP」を開発、販売を開始いたしました。

「AD-800LP」は、これまでの熱による成膜だけでなく、プラズマ生成機構を追加することで様々な条件での多様な成膜が可能となり、多目的に使える研究開発装置です。SiC、GaNパワーデバイスのほか、レーザー、MEMSなど様々なデバイスをターゲットに販売を拡大してまいります。



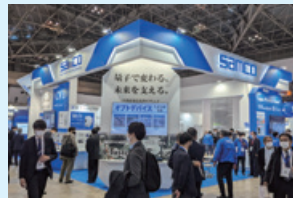
AD-800LP

展示会

『SEMICON Japan 2022』に出展

2022年12月14日から16日までの3日間、世界最大級のエレクトロニクス製造サプライチェーンの総合展示会である『SEMICON Japan 2022』が東京ビッグサイトで開催されました。開会式には岸田文雄首相が出席されるなど、今後のデジタル化や脱炭素社会を支える半導体への関心の高さが伺えました。

当社ブースでは「量子で変わる、未来を変える。」をテーマに、新製品「AD-800LP」や「クラスターH™」などを紹介し、連日多くの来場者で賑わいました。

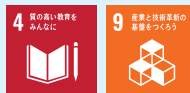


当社ブースの様子

先端技術

量子コンピューター開発用に装置を納入

茨城県にある産業技術総合研究所が開設したシリコン量子ビットなどの次世代デバイスの試作共用ライン「COLOMODE」に、量子コンピューター開発用として計4台の装置を納入いたしました。量子コンピューターは、新材料開発や創薬研究などへの応用が期待され、国内外での研究開発が盛んに行われており、当社の装置や技術が用いられております。



納入した当社装置4台

(2023年1月31日現在)

■ 会社概要

商号 サムコ株式会社（英文：SAMCO INC.）  
 設立 1979年（昭和54年）9月  
 事業内容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入  
 資本金 1,663,687,288円  
 従業員数 171名  
 本社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地  
 TEL(075)621-7841 FAX(075)621-0936  
 国内拠点 本社（京都）、東日本営業部（東京）、東海支店（愛知）、つくば営業所（茨城）  
 海外拠点 米国（カリフォルニア・ニュージャージー）、台湾、シンガポール、中国（上海・北京）、マレーシア  
 研究拠点 本社研究開発センター（京都）、オプティフィルムズ研究所（米国）

■ 役員

代表取締役会長兼CEO 辻 理  
 代表取締役社長兼COO 川 邊 史  
 取締役常務執行役員 山下 晴彦  
 取締役執行役員 宮本 省三  
 佐藤 清志  
 社外取締役 村上 正紀  
 高須 秀視  
 藤田 静雄  
 常勤監査役 辻村 茂  
 社外監査役 木村 隆之  
 西尾 方宏  
 常務執行役員 竹之内 聡一郎  
 外山 信一  
 執行役員 関 伸修  
 ピーター・ウッド  
 本山 慎一  
 松出 和男

■ 株式の状況

発行可能株式総数 ..... 14,400,000株  
 発行済株式の総数 ..... 8,042,881株  
 株主数 ..... 6,798名  
 大株主の状況

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	1,150,800	14.3
(一財)サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	877,907	10.9
サムコエンジニアリング(株)	850,282	10.6
(株)日本カストディ銀行(信託口)	402,400	5.0
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行(株)(投信口)	130,100	1.6
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	112,538	1.4
立田 利明	103,099	1.3

■ 所有者別株式分布状況

